



PCF85116-3

2048 × I2C总线接口的 8位CMOS EEPROM

2004年10月4日至25日

产品数据

1. 描述

PCF85116-3是16千位（2048）×8位）浮动门电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）。通过使用冗余的EEPROM单元它对单个位错误是容错的。在大多数情况下，还包括多位错误。与传统的EEPROM相比，该功能显著提高了可靠性。回忆。由于采用了完整的CMOS技术，功耗较低。该使用电压倍增器在片上产生编程电压。

由于数据字节是通过串行I2C总线接收和传输的，所以使用一个封装八个引脚是足够的。只需要一个PCF85116-3设备即可支持全部8个设备256块 ×每个8位。

E / W周期的定时在内部进行，因此不需要外部元件需要。引脚7（WP）的写保护输入允许禁止写入命令来自主人的一个硬件信号。当引脚7为高电平时，EEPROM中的数据为保护。接收到的数据字节将不会被PCF85116-3确认。EEPROM的内容不会改变。

备注：PCF85116-3的引脚和地址与PCx85xxC-2系列兼容。PCF85116-3覆盖16kbits的整个地址空间；地址输入是否需要更长时间因此，引脚1到3没有连接。写保护输入（WP）在第7针。

2. 特征

- s 低功耗CMOS：
 - x 最大工作电流1.0 mA
 - x 最大待机电流10 μA（5.5 V），典型值4 μA
- s 16个字节的非易失性存储组织为8个256个块 ×每个8位
- s 单电源供电，最低工作电压为2.7V
- s 片上电压倍增器
- s 串行输入/输出I2C总线（100 kbit / s标准模式和400 kbit / s快速模式）
- s 写入操作：多字节写入模式，最多32字节
- s 写保护输入
- 读取操作：
 - x 顺序读取
 - 随机读取
- s 内部写入定时器（无需外部元件）
- 上电复位
- 通过使用冗余EEPROM单元实现高可靠性



PHILIPS

- s 耐受度：在T amb = 22°C时 1000000次擦除/写入（E / W）周期
- s 20年非易失性数据保留时间（最小）
- s 引脚和地址与PCx85xxC-2系列兼容
- s ESD保护每个JESD22-A114超过2000 V HBM，每个200 V MM
JESD22-A115和1000 V CDM每个JESD22-C101
- 对JESDEC标准JESD78进行闭锁测试，超过100 mA
- 提供DIP和SO封装

3. 快速参考数据

表格1： 快速参考数据

符号	参数	条件	敏	典 型	马克斯	单元
V DD	电源电压		2.7	-	5.5	V
我 DDR	供电电流读取	f SCL = 400kHz; V DD = 5.5V	-	-	1.0	嘛
我 DDW	供电电流 E / W	f SCL = 400kHz; V DD = 5.5V	-	-	1.0	嘛
我不 介意	备用电源电流	V DD = 2.7V	-	-	6	μA
		V DD = 5.5V	-	-	10	μA

4. 订购信息

表2： 订购信息

型号	包		
	名称	描述	版
PCF85116-3P / 01	DIP8	塑料双列直插式封装; 8导联（300密耳）	SOT97-1
PCF85116-3T / 01	SO8	塑料小轮廓包装; 8导联; 身体宽度3.9毫米	SOT96-1

4.1订购选项

表3： 订购选项

型号	上面的标记
PCF85116-3P / 01	PCF85116-3
PCF85116-3T / 01	85116-3

5. 框图

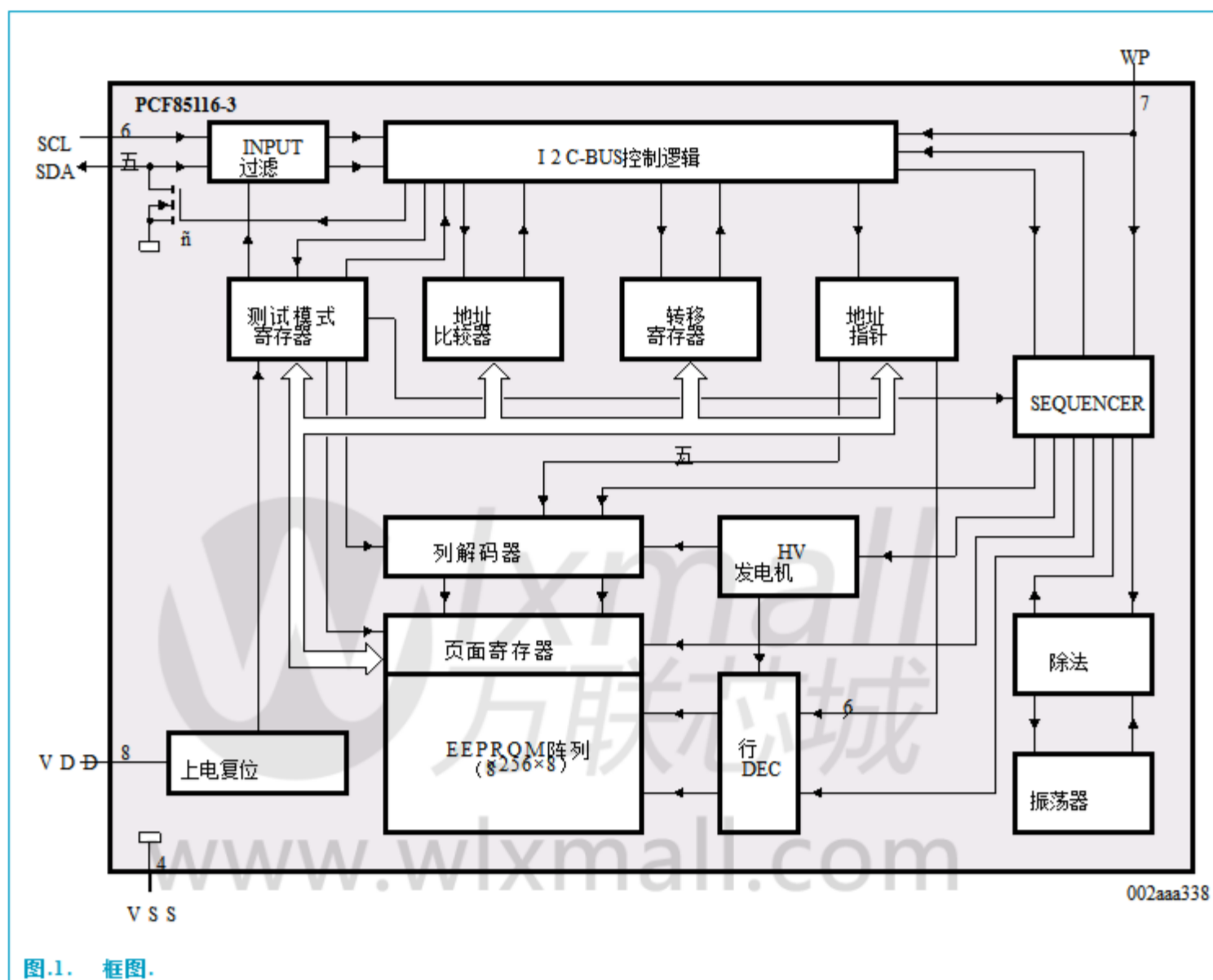
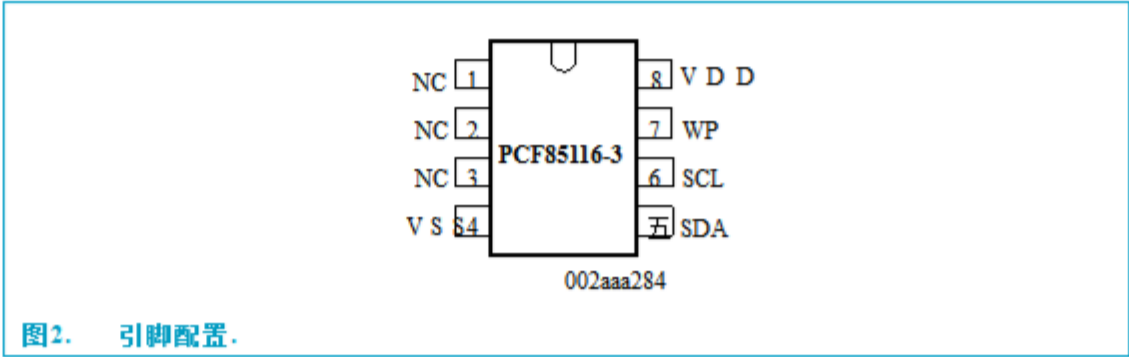


图.1. 框图.

6. 固定信息

6.1 钉住



6.2 引脚说明

表4: 引脚描述

符号	销	描述
NC	1	未连接
NC	2	未连接
NC	3	未连接
V SS	4	负电源电压
S D A	五	串行数据输入/输出 (I2C总线)
SCL	6	串行时钟输入 (I2C总线)
WP	7	高电平有效的写保护输入
V DD	8	正电源电压

7. 设备选择

表5: 设备选择代码

选择	设备代码				芯片启用			R / W
位	B 7 [1]	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
设备	1010				MEM SEL 2	MEM SEL 1	MEM SEL 0	R / W

[1] The Most Significant Bit (MSB) 'B7' is sent first.

8. 功能说明

8.1 I²C总线协议

I²C总线用于不同IC或模块之间的2路2线通信。该

串行总线由两条双向线组成：一个用于数据信号（SDA），另一个用于数据信号时钟信号（SCL）。

SDA和SCL线都必须通过a连接到正电源电压上拉电阻。

以下协议已被定义：

- 数据传输只能在总线不繁忙时启动。
- 数据传输期间，数据线必须在时钟线保持稳定高。时钟线为高电平时数据线的变化将被解释为控制信号。

8.1.1 巴士条件

以下公交条件已被定义：

总线不忙 - 数据线和时钟线都保持高电平。

开始数据传输 - 数据线状态从高电平变为低电平，当时钟为高电平时，定义START条件。

停止数据传输 - 数据线状态的变化，从低到高，当时钟为高电平时，定义停止条件。

数据有效 - 在START之后，数据线的状态代表有效数据条件下，数据线在时钟的高电平期间保持稳定信号。每位数据有一个时钟脉冲。

8.1.2 数据传输

每个数据传输都以START条件启动，并以STOP结束条件。START和STOP之间传输的数据字节数在E / W模式下，条件限制为32个字节。

数据传输在读取模式下是无限的。信息以字节传输并且每个接收器用第九位确认。

在I²C总线规范中，标准速度模式（100 kHz时钟速率），a快速模式（400 kHz时钟频率）和高速模式（3.2 MHz时钟频率）被定义。PCF85116-3只能在标准和快速模式下工作。

根据定义，发送信号的设备称为“发射器”和设备接收信号的信号称为“接收器”。控制信号的设备是称为“主”。由主设备控制的设备称为“从设备”。

每个字节后跟一个确认位。这个确认位是一个高电平，由发射器把公共汽车上。主人产生一个额外的确认相关时钟脉冲。被寻址的从属接收器必须产生一个接收每个字节后确认。

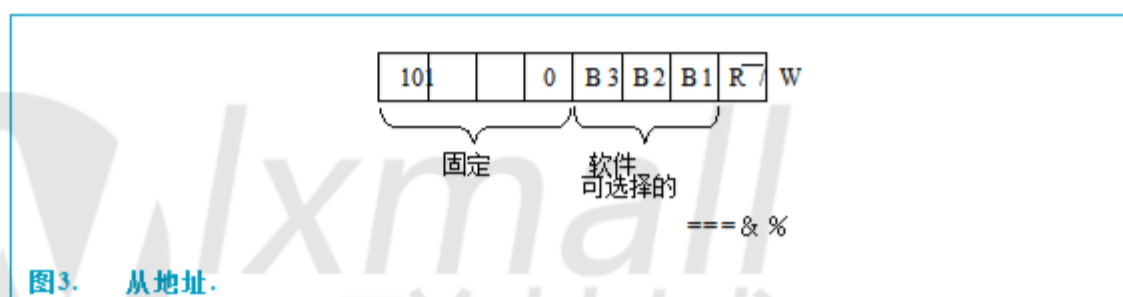
主接收器必须在接收到每个字节后产生一个确认
已经从主发射机输出。

承认的设备在确认期间必须拉低SDA线
时钟脉冲，使SDA线在高电平期间稳定为低电平
确认相关的时钟脉冲。

设置和保持时间必须考虑在内。主接收机必须发信号
通过不在最后一个字节上产生一个确认，数据结束到从属发送器
已经从从属钟表了。在这种情况下，发射机必须离开
数据线为高电平，使主机产生STOP条件。

8.1.3 设备寻址

在启动条件之后，总线主机必须输出从机地址
正在访问。从地址的四个MSB是设备类型标识符（请参阅
图3）。对于PCF85116-3，它固定为“1010”。



从站地址字段（B3，B2，B1）的下三个重要位是块
选择位。主机使用它从八个块中选择一个
（1块= 256字节的内存）。实际上，这是三个最重要的部分
的地址。

从地址（R / W）的最后一位定义要执行的操作。什么时候
读/写设置为逻辑1，选择读操作。

8.1.4 写操作

字节/字写入：对于写操作，PCF85116-3需要第二个地址
科幻场。这个地址字段是一个可以访问八个字节中的任何一个的字地址
内存块。一旦收到字地址，PCF85116-3就会响应
一个确认并等待接下来的八位数据，再次用一个
确认。字地址自动递增。主人现在可以
通过产生一个停止条件来终止传输。

在这个停止条件之后，E / W周期开始，总线空闲
传输。其持续时间最长为10毫秒。

在E / W周期期间，从接收器不会发送确认位
通过I²C总线寻址。

页面写入：PCF85116-3能够进行32字节的页面写入操作。它是
以与字节写入操作相同的方式启动。主人可以传达
到一个传输内的32个数据字节。收到每个字节后，PCF85116-3
将作出回应的承认。主设备通过生成一个
停止条件。此模式下的最大E / W总时间为10 ms。

在收到每个数据字节之后，存储器地址的高6位提供对64个内存页面之一的访问保持不变。五内存地址的低位将只会递增（见图4）。通过这五个位在访问页面中选择一个字节。通过增量内存地址可能会从31变为0，从63变为32等。如果主设备发送生成STOP条件之前超过32个字节，寻址内的数据页面可能被覆盖，并可能发生不可预知的结果。就像在写字节一样操作，所有输入都被禁止，直到完成内部写入周期。

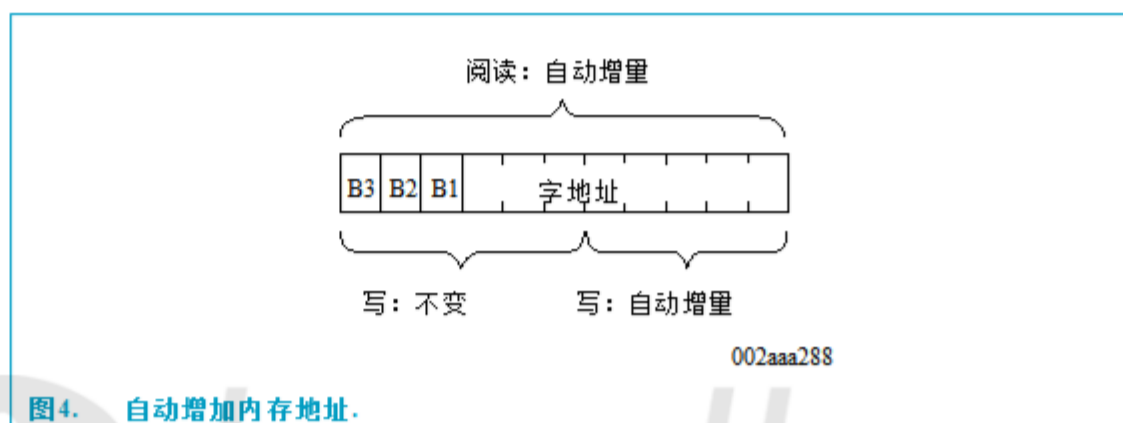


图4. 自动增加内存地址。

备注：如果引脚WP为低电平，则对EEPROM的写入访问被使能。什么时候WP为高电平，EEPROM被写保护，并且不会有应答数据发送时PCF85116-3。但是，承认后将给予从机地址和字地址。

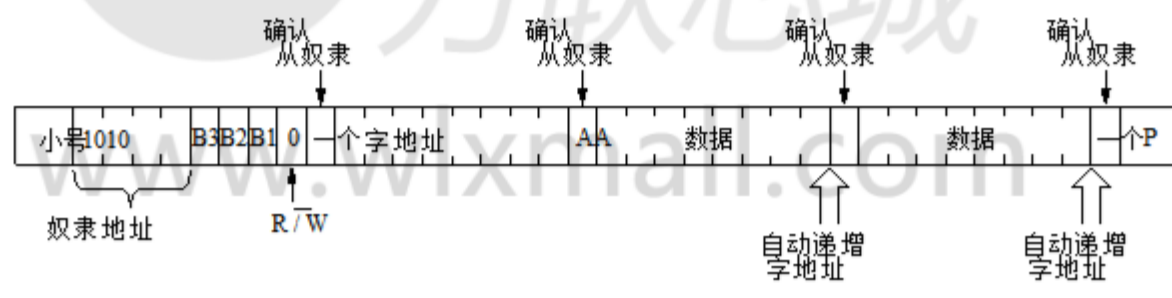


图5. 自动增加内存地址;两个字节写入。

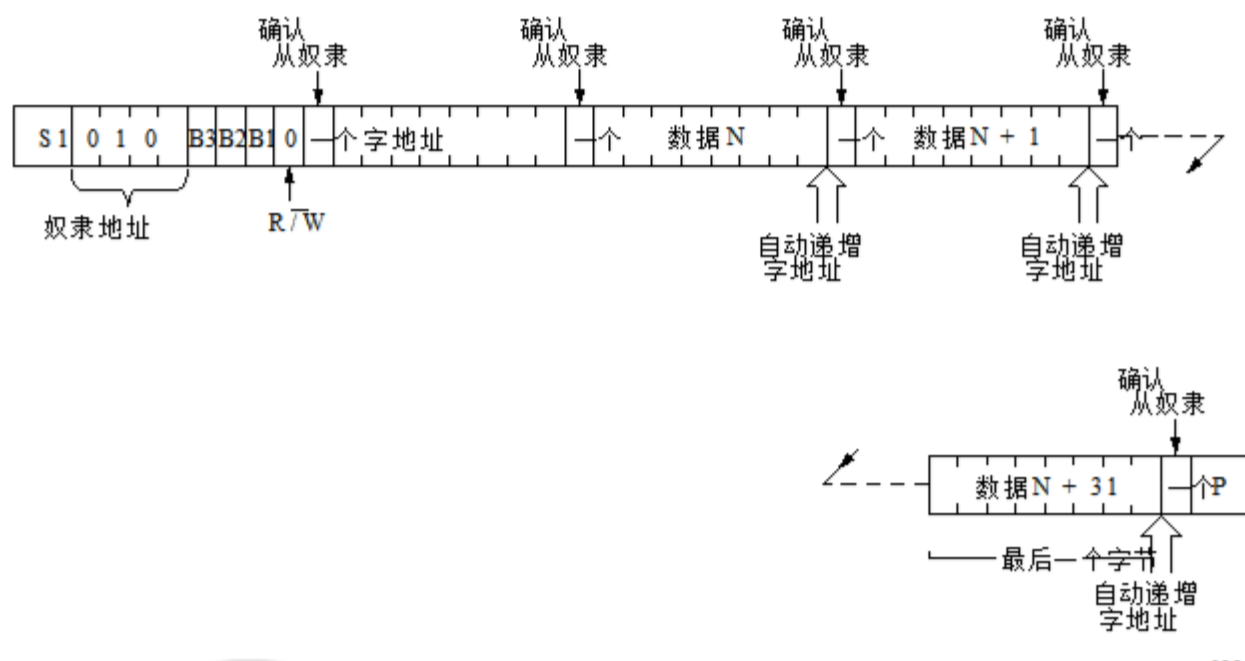


图6. 页面写操作; 32个字节.

8.1.5 阅读操作

读操作的启动方式与写操作一样

从机地址 (R / W) 的 LSB 被设置为逻辑 1 的例外。

有三个基本的读取操作：当前地址读取，随机读取和顺序读取。

备注：在读操作过程中，存储器地址的所有位都递增

每传输一个数据字节后。与写作操作相反的是，

内存地址从 2047 到 0 (见图 8)。

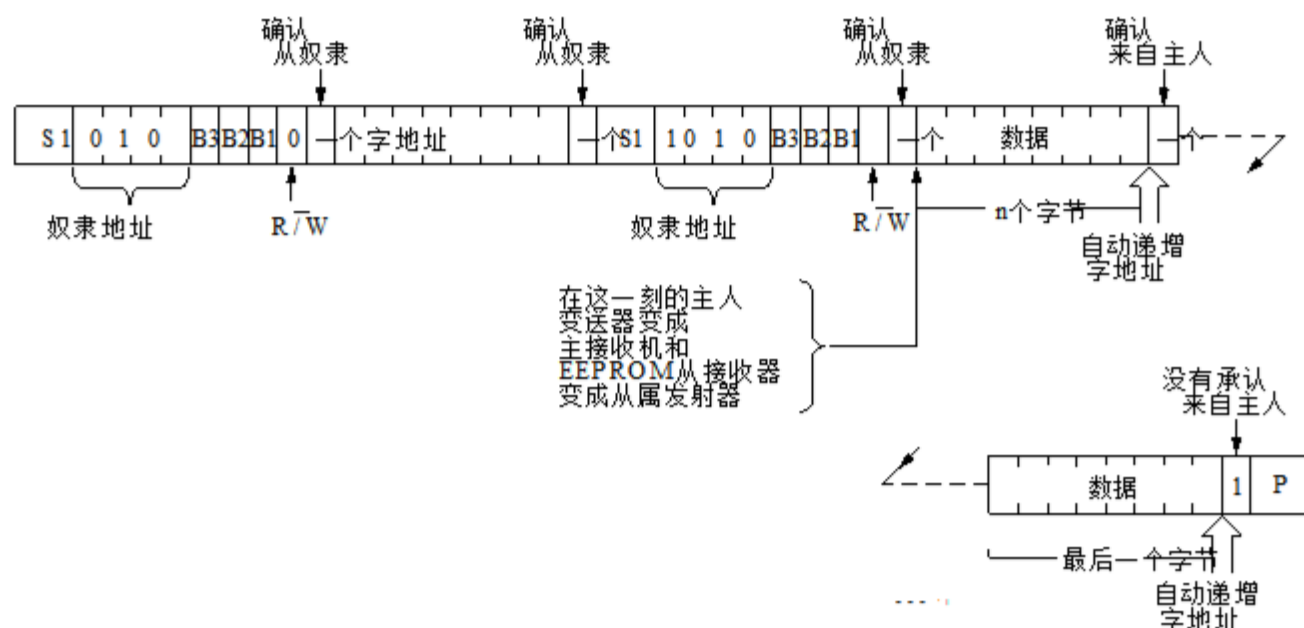


图7. 主设置字地址（写字地址;读数据）后读主机PCF85116-3从机;
顺序读取.

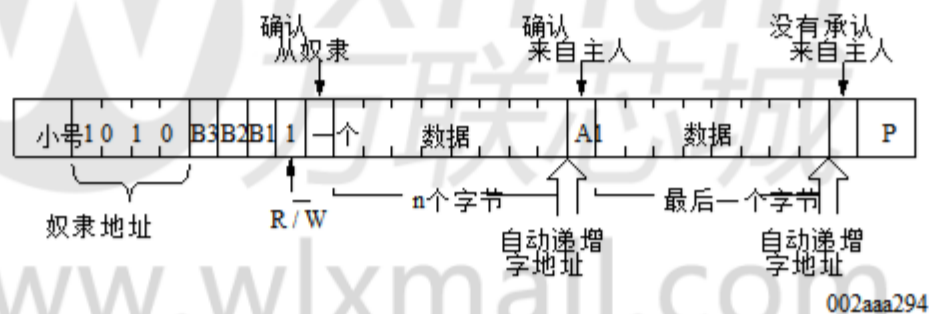


图8. 主机在第一个字节（读取模式）后立即读取PCF85116-3;当前地址读取.

9. 限制值

表 6: 限制值
根据绝对最大额定值系统 (IEC 60134)。

符号	参数	条件	敏	马克斯	单元
V DD	电源电压		-0.3	+6.5	V
V i	输入引脚上的输入电压	$ Z_{我} > 500\Omega$	V SS - 0.8	+6.5	V
我 我	输入电流在任何输入引脚		-	1	嘛
我 o	输出电流		-	10	嘛
T stg	储存温度		-65	+150	C
T amb	操作环境温度		-40	+ 85	C
V esd	静电放电电压		[1] 2-		千伏

[1] T amb = 22°C 时 ESD 人体模型 Q22 ; 按照 MIL-STD-883C 方法 3015 进行放电程序.



10. 特点

表 7: 特点

$V_{DD} = 2.7$ 至 $3.5V$; $V_{SS} = 0V$; $T_{amb} = -40$ 至 $+85^{\circ}C$; 除非另有规定。

符号	参数	条件	敏	典型	马克斯	单元
供应						
V DD	电源电压		2.7	-	5.5	V
我 DDR	供电电流读取	f SCL = 400kHz; V DD = 5.5V	-	-	1.0	嘛
我 DDW	供电电流E / W	f SCL = 400kHz; V DD = 5.5V	-	-	1.0	嘛
我 DD (stb)	备用电源电流	V DD = 2.7V	-	-	6	μA
		V DD = 5.5V	-	-	10	μA
SDA输入/输出 (引脚5)						
V IL	低电平输入电压		-0.8	-	0.3 V DD	V
V IH	高电平输入电压		0.7 V DD	-	+6.5	V
V OL1	低电平输出电压	我 OL = 3毫安; V DD (min)	-	-	0.4	V
V OL2		我 OL = 6毫安; V DD (min)	-	-	0.6	V
我 LO	输出漏电流	V OH = V DD	-		1	μA
(f)	输出从V IHmin到V ILmax的下降时间	[1]				
	V OL1的灌电流高达3 mA		20 + 0.1 C b-		250	NS
	V OL2的灌电流达6 mA		20 + 0.1 C b-		250	NS
t SP	峰值脉冲宽度受到抑制 滤波器		0	-	100	NS
C i	输入电容	V I = V SS	-	-	10	pF的
SCL输入 (引脚6)						
V IL	低电平输入电压		-0.8	-	0.3 V DD	V
V IH	高电平输入电压		0.7 V DD	-	+6.5	V
我 李	输入漏电流	V I = V DD 或 V SS	-		±1	μA
f SCL	时钟输入频率		0	-	400	千赫
t SP	峰值脉冲宽度受到抑制 滤波器		0	-	100	NS
C i	输入电容	V I = V SS	-		7	pF的
WP输入 (引脚7)						
V IL	低电平输入电压		-0.8	-	0.1 V DD	V
V IH	高电平输入电压		0.9 V DD	- V DD + 0.8		V
数据保留时间						
t S	数据保留时间	T amb = 55℃	20	-	-	年份

[1] 总线电容范围为10至400 pF (C_b — 一条总线的总电容, 单位为pF)。

11. 我的 C-bus 特点

表 8: 我有 2 个 C-bus 的特点

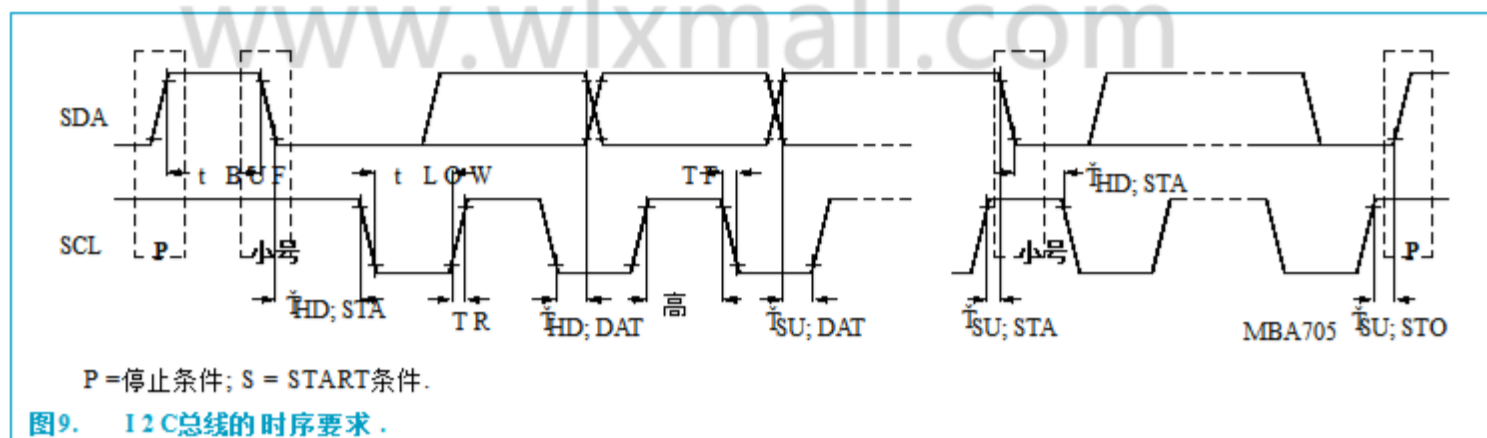
所有定时值在工作电源电压和环境温度范围内均有效，并参考 V_{IL} 和 V_{IH}

输入电压从 V_{SS} 变到 V_{DD} ；见图 9。

符号	参数	条件	标准模式		快速模式		单元
			敏	马克斯	敏	马克斯	
f SCL	时钟频率		0	100	0	400	千赫
t BUF	公共汽车之前必须是免费的 新的传输可以开始		4.7	-	1.3	-	微秒
t HD; STA	START 条件保持时间后 产生第一个时钟脉冲		4	-	0.6	-	微秒
t LOW	低电平时钟周期		4.7	-	1.3	-	微秒
高	高电平时钟周期		4	-	0.6	-	微秒
SU; STA	START 条件的建立时间	重复开始	4.7	-	0.6	-	微秒
t HD; DAT	数据保存时间						
	为 CBUS 兼容的主人		五	-	-	-	微秒
	用于 I2C 总线设备	[1]	0-		0	-	NS
t SU; DAT	数据建立时间		250	-	100	-	NS
t r	SDA 和 SCL 上升时间		-	1000	$20 + 0.1 C_b$ [2]	300	微秒
t f	SDA 和 SCL 下降时间		-	300	$20 + 0.1 C_b$ [2]	300	NS
SU; STO	停止状态的设定时间		4	-	0.6	-	微秒

[1] 桥接 SCL 下降沿的未定义区域所需的保持时间（不超过 300 ns）必须由内部提供一个发射器。

[2] C_b — 一条总线的总电容，单位为 pF。



12. 编写循环限制

表 9: 写周期限制
上电复位电路以 I2C 总线逻辑的建立时间 复位 WP 输入到 V SS. ≤10 微秒. 通过连接来实现芯片

符号	参数	条件	敏	典 型	马克斯	单元
E / W 周期时间						
t E / W	E / W 周期时间		-	-	10	女士
耐力						
N E / W	每字节的 E / W 周期	T amb = -40至+85°C	100000	-	-	周期
		T amb = 22°C	百万	-	-	周期



13.包大纲

SO8：塑料小轮廓包装；8导联；身体宽度3.9毫米

SOT96-1

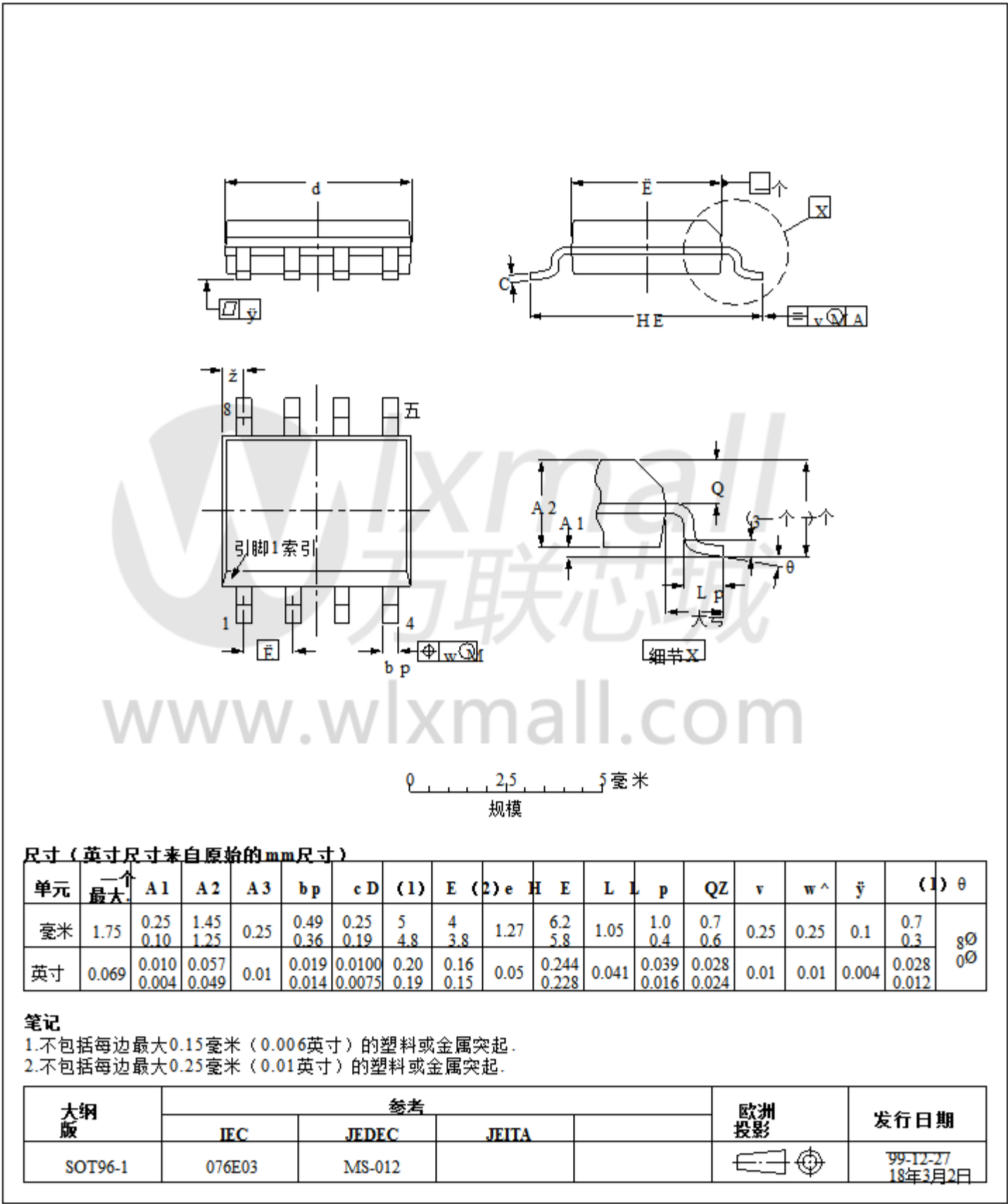


图10. SO8（SOT96-1）。

DIP8: 塑料双列直插式封装; 8 导联 (300 密耳)

SOT97-1

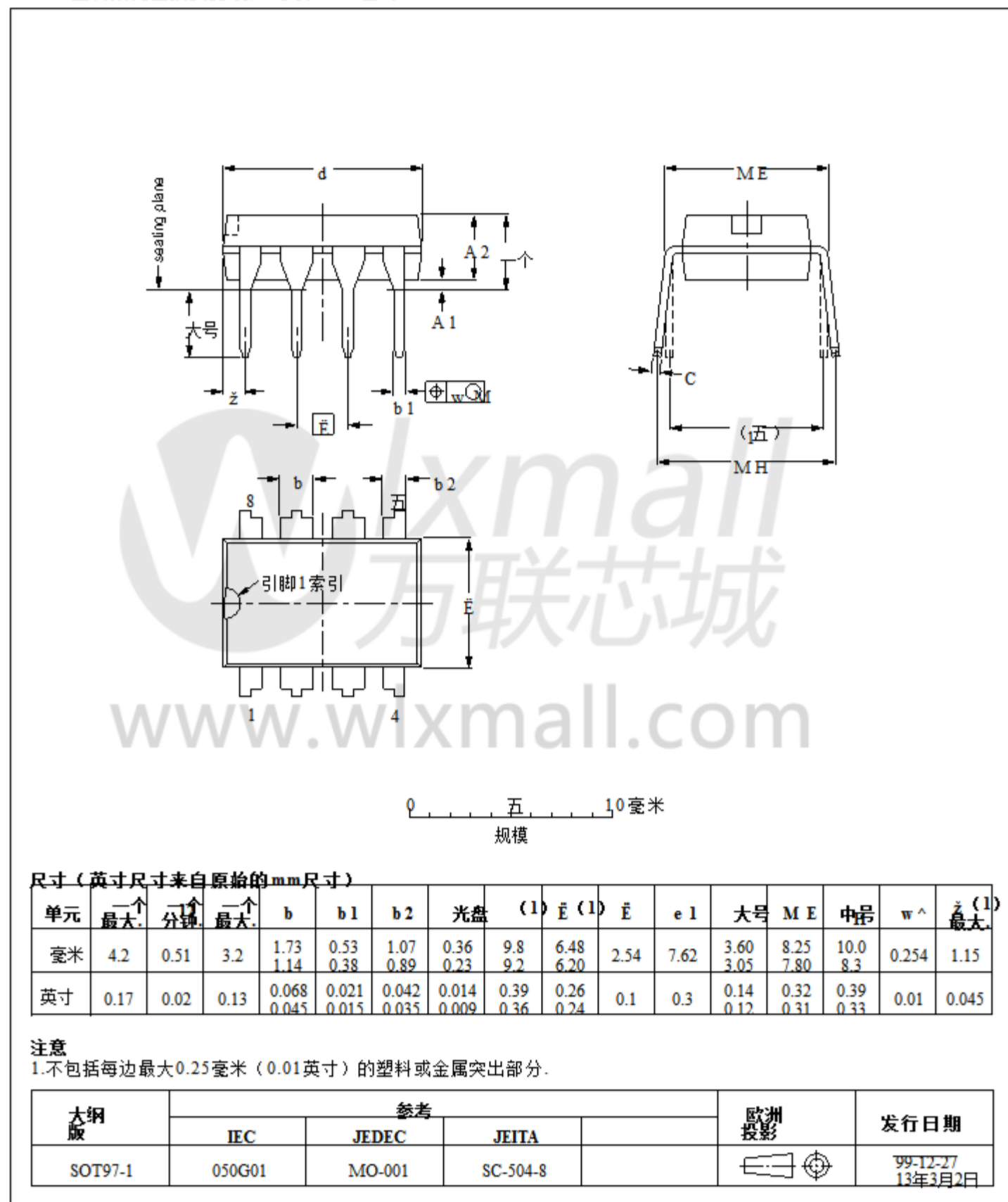


图 11. DIP8 (SOT97-1)

14. 焊接

14.1 引言

本文对复杂的技术提供了一个非常简短的见解. 一个更深入的帐户焊接 IC 可以在我们的网站找到 数据手册 IC26: 集成电路包裹 (文件订单号码 9398 652 90011) .

没有适用于所有 IC 封装的焊接方法. 波峰焊通常是当通孔和表面安装元件混合在一个时, 最好使用印刷电路板. 波峰焊仍然可以用于某些表面贴装 IC, 但是它不适用于精细的 SMD. 在这些情况下, 回流焊是推荐的. 由立法和环境力量驱动, 在世界范围内使用无铅焊膏正在增加.

14.2 通孔安装封装

14.2.1 通过浸焊或焊波进行焊接

导线在波浪中的典型停留时间在 250 到 3 秒到 4 秒之间 °C 或 265 °C, 取决于所使用的焊料, 分别为 SnPb 或 Pb.

连续焊波的总接触时间不得超过 5 秒.

该设备可能会安装到座位的平面, 但温度塑料体不得超过规定的最大储存温度 ($T_{stg(max)}$). 如果印刷电路板已经预热, 可能需要强制冷却. 焊接后立即将温度保持在允许范围内.

14.2.2 手工焊接

将烙铁 (24 V 或更少) 放在包装的导线上, 或者在包装的下面座椅平面或不超过 2 毫米. 如果烙铁的温度位小于 300 °C 可能会保持接触达 10 秒. 如果有点温度在 300 到 400 之间 °C, 接触时间可能长达 5 秒.

14.3 表面贴装封装

14.3.1 回流焊接

回流焊接需要焊膏 (细小的焊料颗粒, 通孔和焊料的悬浮液) 粘合剂) 通过丝网印刷, 模版印刷施加到印刷电路板上或在包装放置之前的压力注射器分配.

有几种方法用于反馈; 例如对流或对流/红外在传送式炉中加热. 吞吐时间 (预热, 焊接和焊接) 冷却) 根据加热方法在 100 到 200 秒之间变化.

典型的回流峰值温度范围从 215 到 270 °C 取决于焊料. 粘贴材料. 包装的顶面温度应该是最好的保持:

- 225 以下 °C (SnPb 工艺) 或低于 245 °C (无铅工艺)
- 用于所有 BGA 和 SSOP-T 封装

- 用于包装厚度 ≥ 2.5 毫米
- 用于厚度 < 2.5 mm 和体积的包装 ≥ 350 毫米³ 所谓厚/大包装.
- 低于 240°C (SnPb 工艺) 或低于 260°C (无铅工艺) 封装厚度 < 2.5 mm, 体积 < 350 mm³, 所谓的小/薄包装.

包装上标明的湿度敏感性预防措施必须得到遵守倍.

14.3.2 波峰焊接

传统的单波峰焊不建议用于表面贴装器件 (SMD) 或具有高组件密度的印刷电路板作为焊接桥接而不润湿可能会出现重大问题.

为了克服这些问题, 双波长焊接方法是特别的发达.

如果使用波峰焊, 则必须遵守以下条件才能达到最佳效果结果:

- 使用包含高端流波的双波长焊接方法
向上的压力, 然后是平滑的层流波.
- 对于带有两侧导线和间距 (e) 的包装:
 - 大于或等于 1.27 mm, 占地纵轴优选为平行于印刷电路板的传送方向;
 - 小于 1.27 毫米, 占地纵轴必须平行于印刷电路板的传送方向.

足迹必须在下游端包含焊锡小偷.

- 对于四面有引线的封装, 封装必须放置在 45° 到印刷电路板的传送方向. 足迹必须
在下游和侧角加入焊锡小偷.

$^{\circ}$ 角度

放置期间和焊接前, 包装必须固定一滴
胶粘剂. 粘合剂可以通过丝网印刷, 销钉转移或注射器施加
分配. 包装可以在粘合剂固化后进行焊接.

导波在波浪中的典型停留时间在 250 到 3 秒到 4 秒之间
 265°C , 取决于所使用的焊料, 分别为 SnPb 或 Pb.

$^{\circ}\text{C}$ 或

温和的活化通道将消除去除腐蚀性残留物的需要
大部分应用

14.3.3 手工焊接

通过首先焊接两个对角线的端部引线来固定组件. 使用低
电压 (24 V 或更小) 的烙铁施加到导线的一部分. 联系时间
必须限制在 10 秒内, 最多 300 秒 $^{\circ}\text{C}$.

当使用专用工具时, 所有其他引线可以在一个工序内焊接
在 270 到 320 之间 2 到 5 秒 $^{\circ}\text{C}$.

14.4封装相关的焊接信息

表10： 集成电路封装适用于波峰，回流和浸渍的方法

安装	包 [1]	焊接方法		
		波	回流 [2]	浸渍
通孔 安装	DBS, DIP, HDIP, RDBS, 合适 [3] SDIP, SIL		-	适当
通空穴 表面贴装	PMFP [4]	不合适	不 适当	-
表面贴装	BGA, LBGA, LFBGA, 不合适 SQFP, SSOP-T [5], TFBGA, VFBGA		适当	-
	DHVQFN, HBCC, HBGA 不适合 [6] HLQFP, HSQFP, HSOP, HTQFP, HTSSOP, HVQFN, HVSON, SMS		适当	-
	PLCC [7], SO, SOJ	适当	适当	-
	LQFP, QFP, TQFP	不建议 [7] [8]	适当	-
	SSOP, TSSOP, VSO, 不推荐 [9] VSSOP		适当	-

- [1] 有关BGA封装的更多详细信息，请参阅 (LF) BGA应用笔记 (AN01026) ;从飞利浦半导体销售办公室订购一份。

[2] 所有表面贴装 (SMD) 封装对湿度敏感.根据水分含量，包裹的最高温度（相对于时间）和身体大小，内部存在风险或者由于其中的湿气（所谓的）的蒸发而可能发生外部包装裂缝爆米花效应）。有关详细信息，请参阅中的Drypack信息 数据手册IC26;集成电路包;部分：包装方法。

[3] 对于SDIP封装，纵轴必须平行于输送方向印刷电路板。

[4] 热焊条焊接或手动焊接适用于PMFP封装。

[5] 这些透明塑料封装对回流焊接条件非常敏感，必须绝不能通过一个以上的焊接周期进行处理或经受红外回流焊接峰值温度超过217 在回流气氛中测得的温度为±10°C 烤箱.封装体的峰值温度必须尽可能低。

[6] 这些封装不适合波峰焊接.在散热器底部的版本上侧面，焊料不能穿透印刷电路板和散热器之间.在版本上散热器的顶部，焊料可能沉积在散热器表面。

[7] 如果考虑波峰焊，那么包装必须放置在45 与焊波的角度 方向.封装足迹必须在下游和侧角处包含焊锡窃贼。

[8] 波峰焊适用于间距（e）大于0.8 mm的LQFP，QFP和TQFP封装;它绝对不适用于节距（e）等于或小于0.65 mm的封装。

[9] 波峰焊适用于间距（e）等于或大于的SSOP和TSSOP封装 0.65毫米;（e）等于或小于0.5mm的封装是绝对不适合的。

15.修订历史

表 11: 修订记录

Rev	Date	CPCN	描述
04	20041025	-	产品数据 (9397 750 14217) 莫迪科幻阳离子: •第2页上的表2“订购信息” - 调整“类型编号”以包含“/ 01” - 删除“北美”专栏 • 添加了第3页上的表3“订购选项” (正面标记) • 第5页第8.1.2节“数据传输”: 第三段重写.
03	20020819	-	产品数据 (9397 750 10249) ;工程变更通知853-2356 28772; 取代数据表中的数据 PCF85116-3_2 1997年4月2日 (9397 750 01994) .



16. 数据表状态

水平	数据表状态 [1]	产品状态 [2] [3]	德网络nition
I	客观数据	发展	本数据表包含了产品开发客观规范的数据. 飞利浦半导体保留以任何方式更改规格的权利, 恕不另行通知.
II	初步数据	合格科幻阳离子	本数据表包含初步规范的数据. 补充资料将被公布在晚些时候. 飞利浦半导体公司保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知. 为了改善设计和供应最好的产品.
III	产品数据	生产	本数据表包含产品规格的数据. 飞利浦半导体保留随时改变设计, 制造和供应的权利. 相应将通过客户产品/工艺变更通知 (CPCN) 进行变更.

[1] 请在启动或完成设计之前参考最近发布的数据手册.

[2] 本数据表中描述的器件的产品状态可能已经发生变化. 最新的信息可以在网上找到
网址 <http://www.semiconductors.philips.com>.

[3] 对于描述多个类型编号的数据表, 最高级别的产品状态决定了数据表的状态.

17. 定义

简单规格 - 简短规格的数据是从具有相同类型和标题的完整数据表中提取. 对于详细信息见相关数据表或数据手册.

限定值定义 - 给出的限值符合绝对最大额定值系统 (IEC 60134). 压力超过一个或更多的限制值可能会导致设备永久性损坏. 这些只是压力额定值和在这些或任何设备的操作其他条件超出了特性部分的规定. **specification** 不是暗示的. 暴露于延长期限值可能会影响设备可靠性.

应用程序信息 - 此处描述的任何应用程序这些产品仅用于说明目的. 飞利浦半导体不作任何陈述或保证, 这样的应用程序将适合在没有进一步测试或修改的情况下进行特定的使用.

使用或销售这些产品用于这种应用的客户这样做风险自负, 并同意全额赔偿飞利浦半导体的任何费用这种申请造成的损害.

修改权利 - 飞利浦半导体保留权利对产品进行更改 - 包括电路, 标准单元和/或软件 - 描述或包含在此以改进设计和/或性能. 当产品全面生产 (状态“生产”) 时, 相关的变化将通过客户产品/流程进行沟通更改通知 (CPCN). 飞利浦半导体假定没有对使用这些产品的责任或者责任, 不承担任何责任. 根据任何专利, 版权或面具的许可或标题的权利产品, 并不作任何陈述或保证这些产品没有专利, 版权或掩盖作品侵权, 除非另有规定. **SPEC**网络版.

19. 许可证

18. 免责声明

生命支持 - 这些产品不是设计用于生命支持电器, 设备或者这些产品发生故障的系统. 合理预期会导致人身伤害. 飞利浦半导体

购买飞利浦 I2C 组件



购买飞利浦 I2C 组件传达许可证. 根据飞利浦公司的 I2C 专利使用该组件. I2C 系统提供了符合 I2C 的系统. 飞利浦定义的规格. 这个 **specification** 可以使用代码 9398 393 40011 订购.

联系信息

有关更多信息, 请访问 <http://www.semiconductors.philips.com>.

对于销售办公地址, 请发送电子邮件至: sales.addresses@www.semiconductors.philips.com.

传真: +31 40 27 24825

9397 750 14217

©Koninklijke Philips Electronics NV 2004. 保留

产品数据

2004年10月4日至25日

20 21

内容

1	说明.....	1
2	特征.....	1
3	快速参考数据.....	2
4	订购信息.....	2
4.1	订购选项.....	2
五	框图.....	3
6	固定信息.....	4
6.1	钉住.....	4
6.2	引脚描述.....	4
7	设备选择.....	4
8	功能说明.....	五
8.1	I2C总线协议.....	五
8.1.1	巴士条件.....	五
8.1.2	数据传输.....	五
8.1.3	设备寻址.....	6
8.1.4	写操作.....	6
8.1.5	阅读操作.....	8
9	限制值.....	10
10	特点.....	11
11	I2C总线特性.....	12
12	写周期限制.....	13
13	包大纲.....	14
14	焊接.....	16
14.1	介绍.....	16
14.2	通孔安装封装.....	16
14.2.1	通过浸焊或焊波进行焊接.....	16
14.2.2	手工焊接.....	16
14.3	表面贴装封装.....	16
14.3.1	回流焊接.....	16
14.3.2	波峰焊接.....	17
14.3.3	手工焊接.....	17
14.4	封装相关的焊接信息.....	18
15	修订记录.....	19
16	数据表状态.....	20
17	定义.....	20
18	免责声明.....	20
19	许可证.....	20

